
南亞電路板股份有限公司 2025年前三季營運概況

2025年11月28日



免責聲明

歷史事件的陳述可能包括未經會計師審閱之資訊，其可能有某些不足或缺陷而無法忠實呈現目前南亞電路板股份有限公司之財務狀況或營運結果。

本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與本會明示或暗示的預估有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險等因素。

除主管機關要求公開之資訊外，本公司並無義務揭露或更新對未來產品方面之意見與看法。



議程

- 公司概況
- 財務狀況
- 產品未來發展方向
- 2026年營運策略



公司概況

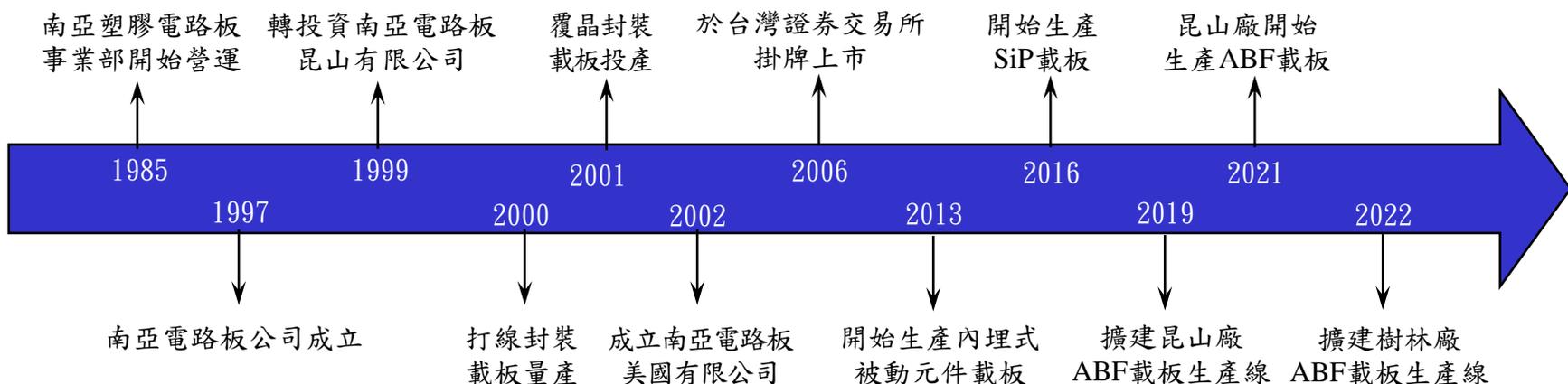
事業簡述

- 南亞塑膠工業股份有限公司之轉投資公司
- 生產與銷售IC載板與一般電路板
- 2025年前三季合併營業額為新台幣 290.1億元。
- 台股上市市值：新台幣1,460.3億元(2025年9月30日)
- 生產廠區：台灣、大陸



公司概況

歷史沿革



- 1985 : 南亞塑膠公司電路板事業部成立並開始生產一般電路板
- 1997 : 經南亞塑膠董事會通過，以轉投資方式成立南亞電路板公司
- 1999 : 轉投資南亞電路板(昆山)有限公司，註冊資本額2,980萬美元
- 2000 : 進入IC載板領域並量產打線封裝載板
- 2001 : 進行技術升級，開始投產覆晶封裝載板
- 2002 : 成立南亞電路板(美國)有限公司
- 2006 : 正式於台灣證券交易所掛牌上市，交易代號為8046
- 2013 : 產品技術升級，開始生產內埋式被動元件載板
- 2016 : 開始生產系統級封裝載板(System in Package, SiP)
- 2019 : 因應市場需求，開始於昆山廠擴建ABF載板生產線
- 2021 : 昆山廠開始生產ABF載板
- 2022 : 樹林廠開始生產ABF載板



財務狀況

近三年合併營業收入(IFRS)

新台幣百萬元

營業額

35,000

30,000

25,000

20,000

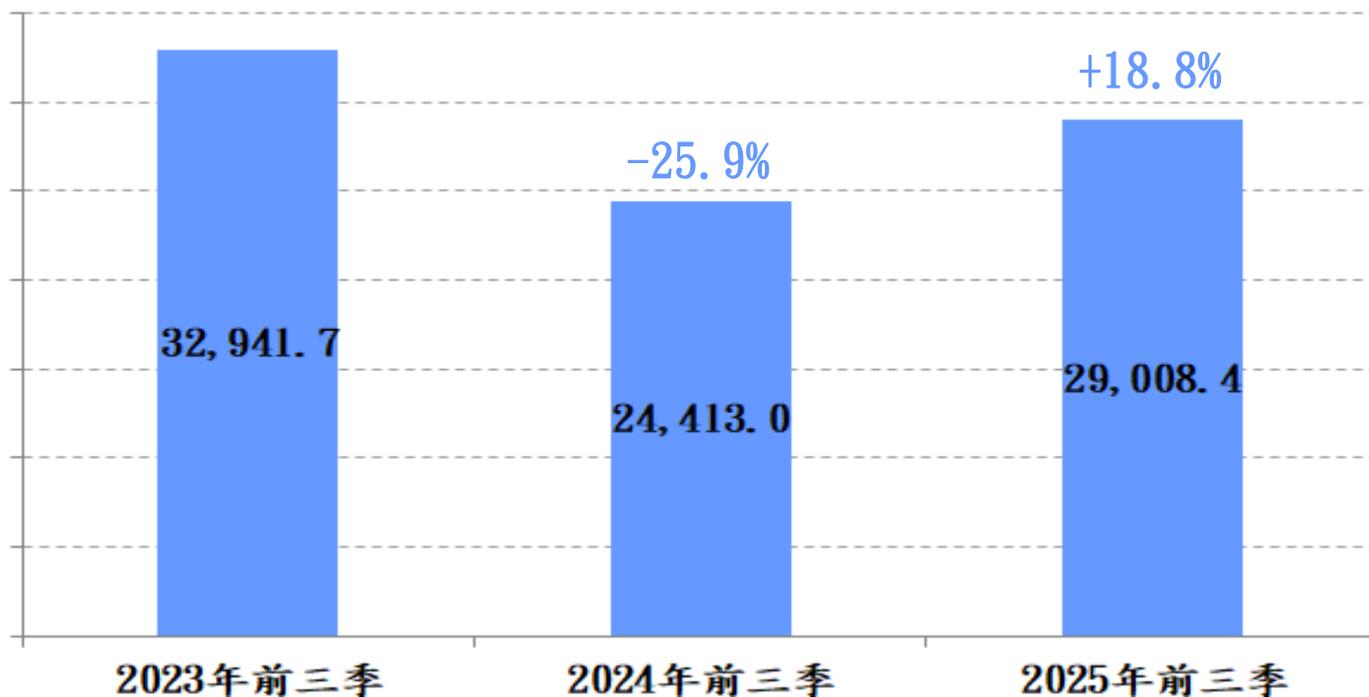
15,000

10,000

5,000

0

■ 年成長率



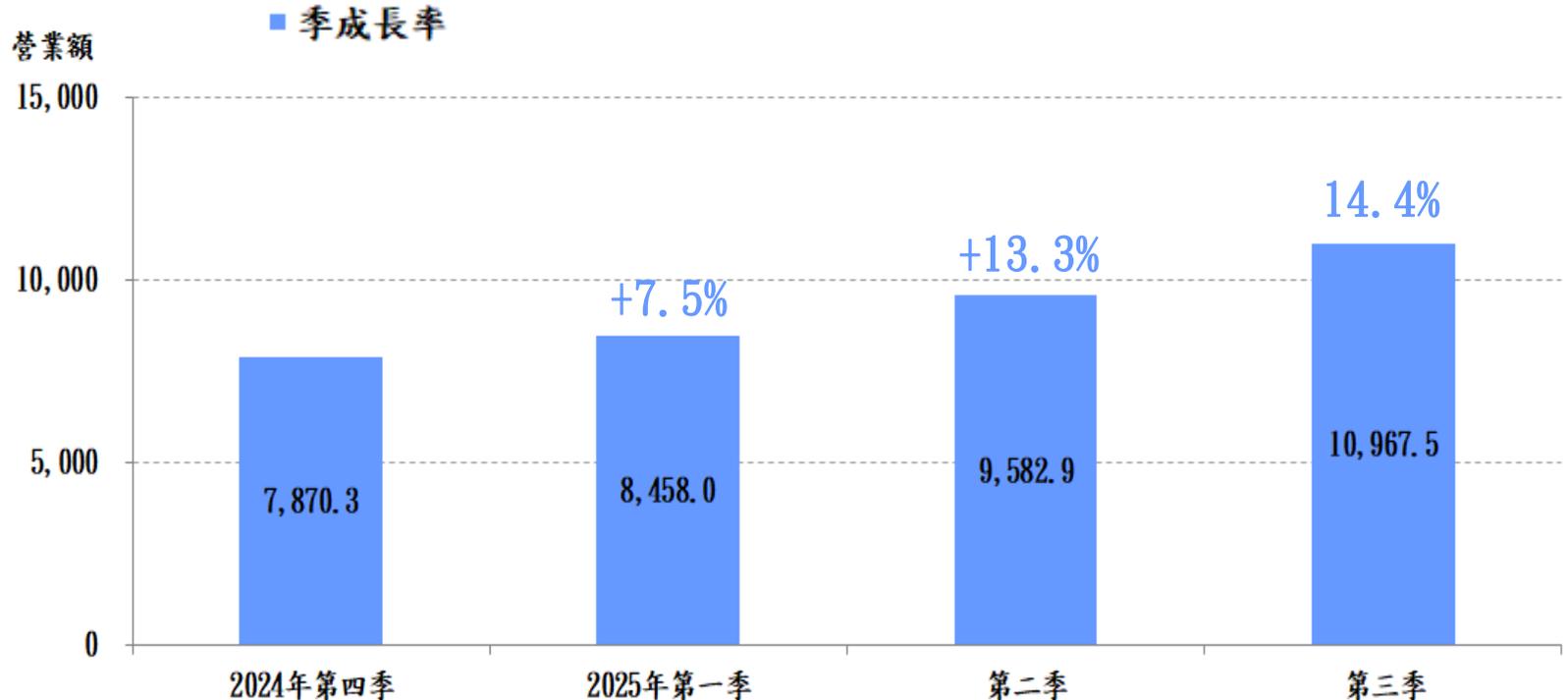
- 2024年前三季營收較2023年同期減少25.9%:
網通產品持續庫存調整，2024年前三季營收比2023年同期下滑。
- 2025年前三季營收較2024年同期增加18.8%:
資料中心升級網通設備，且AI PC銷售提升，相關產品需求提高，2025年前三季營收比2024年同期提高。



財務狀況

近一年每季合併營業收入(IFRS)

新台幣百萬元

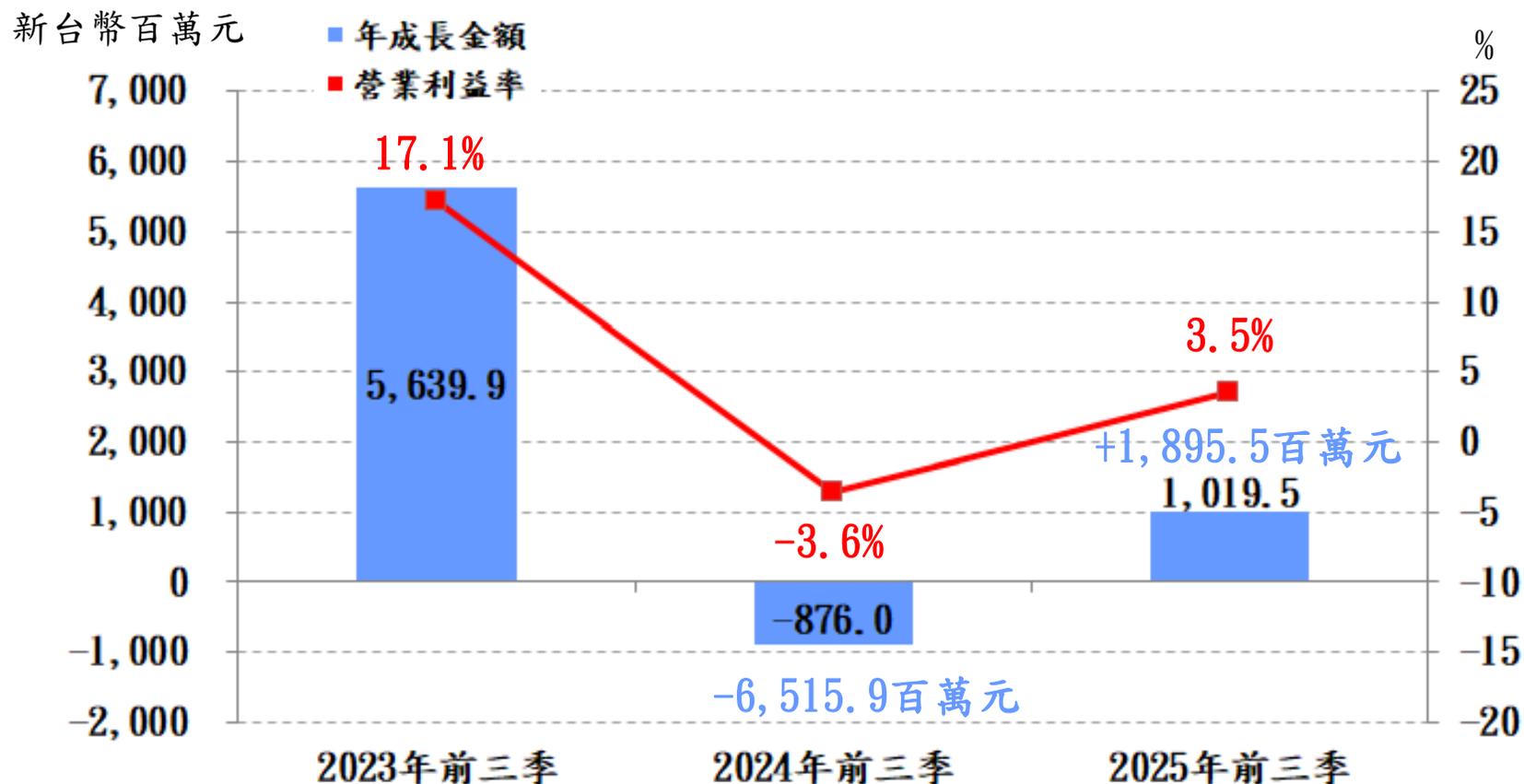


- 2025年第一季營收較2024年第四季增加7.5%:
資料中心對網通產品的需求提高，致第一季營收比第四季成長。
- 2025年第二季營收較2025年第一季增加13.3%:
雲端與邊緣運算產品需求再提升，使第二季營收比第一季增加。
- 2025年第三季營收較2025年第二季增加14.4%:
雲端應用產品穩健成長，記憶體需求復甦，第三季營收再提升。



財務狀況

近三年營業利益

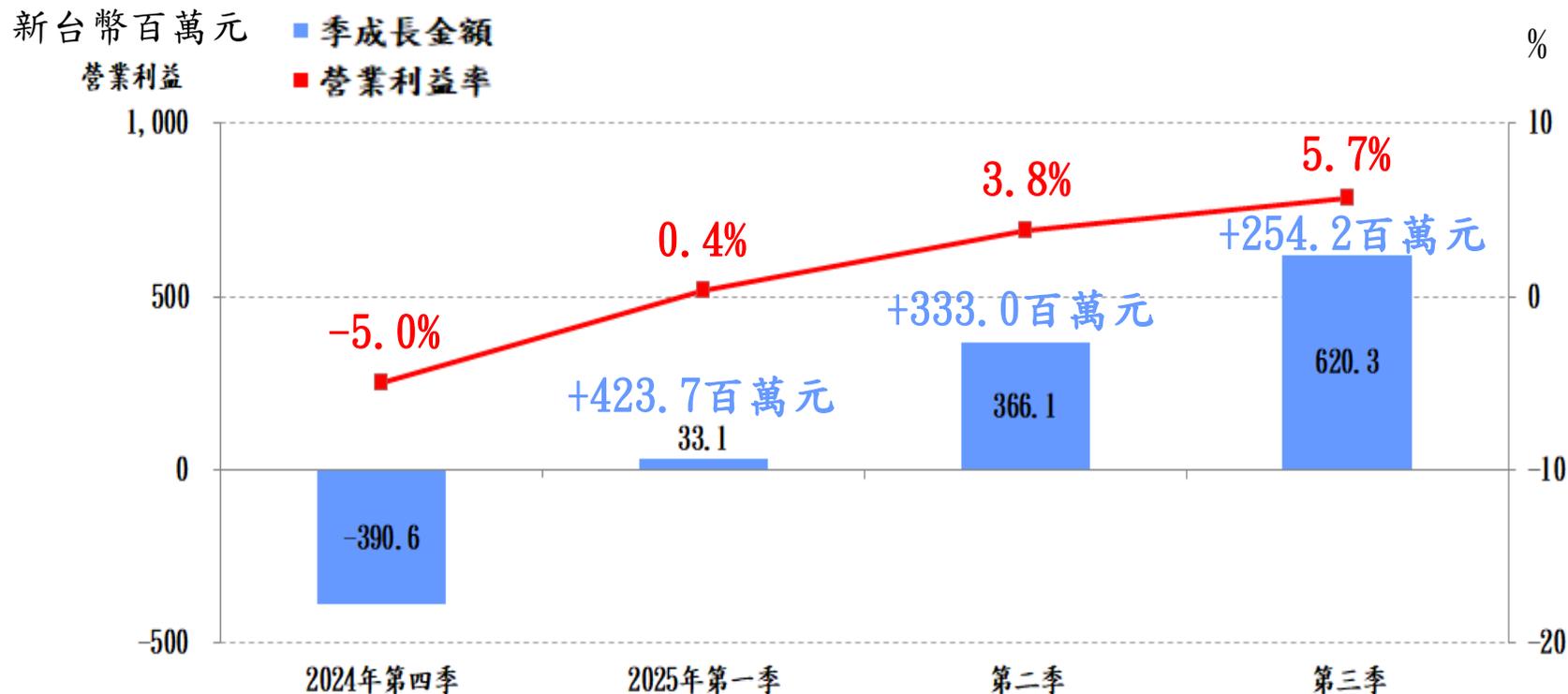


- 2024年前三季營業利益較2023年同期減少6,515.9百萬元：
因網通產品需求疲弱，營收規模縮小，致營業利益減少。
- 2025年前三季營業利益較2024年同期增加1,895.5百萬元：
雲端應用產品銷售比重提升，改善產品組合，致營業利益增加。



財務狀況

近一年每季營業利益

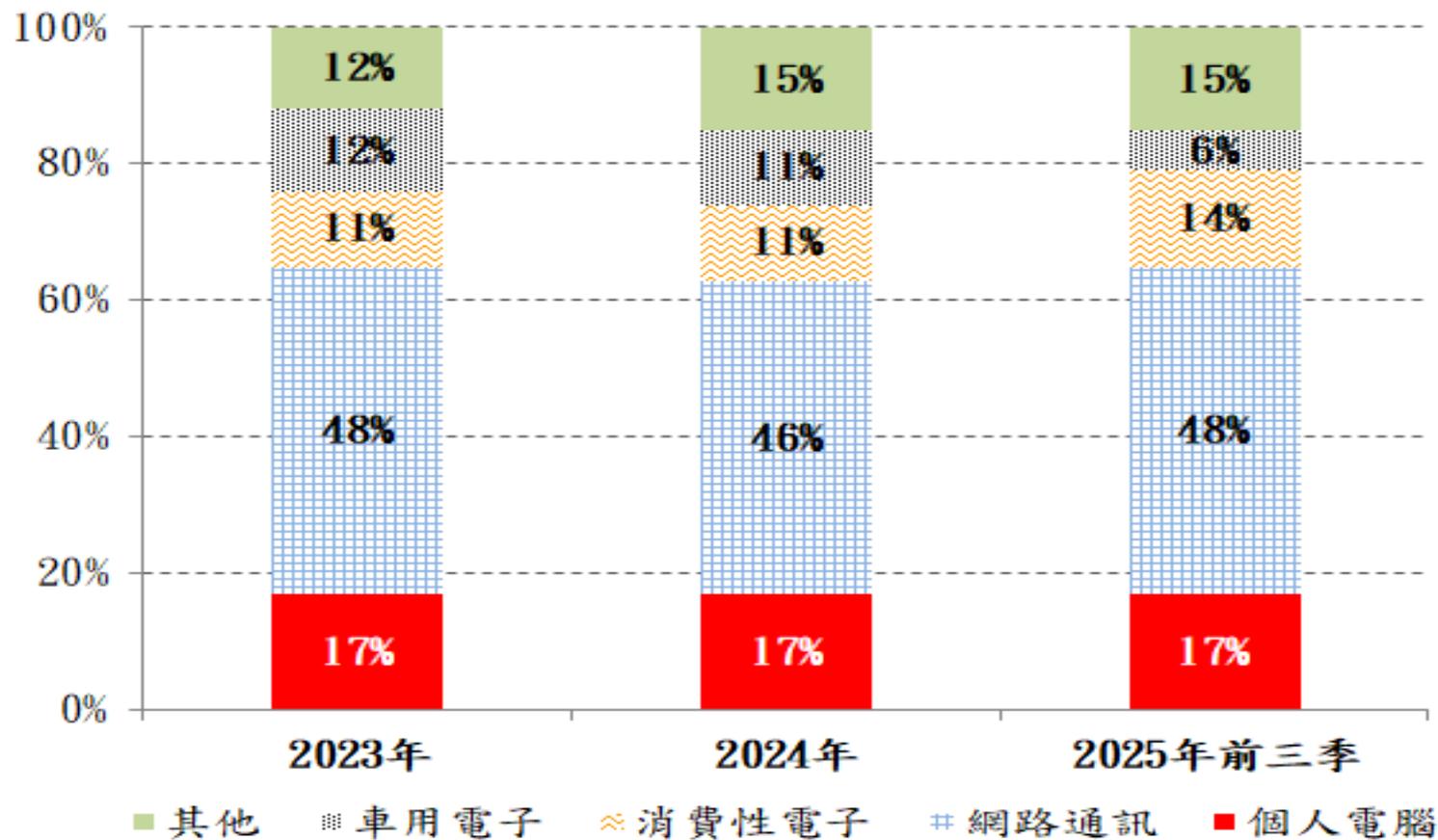


- 2025年第一季營業利益較2024年第四季增加423.7百萬元：
高階網通產品銷售提升，致第一季營業利益比第四季增加。
- 2025年第二季營業利益較2025年第一季增加333.0百萬元：
高階雲端與邊緣運算應用產品需求提升，第二季營業利益再提高。
- 2025年第三季營業利益較2025年第二季增加254.2百萬元：
資料中心與記憶體產品需求提升，第三季營業利益比第二季增加。



財務狀況

營業收入結構(應用別)

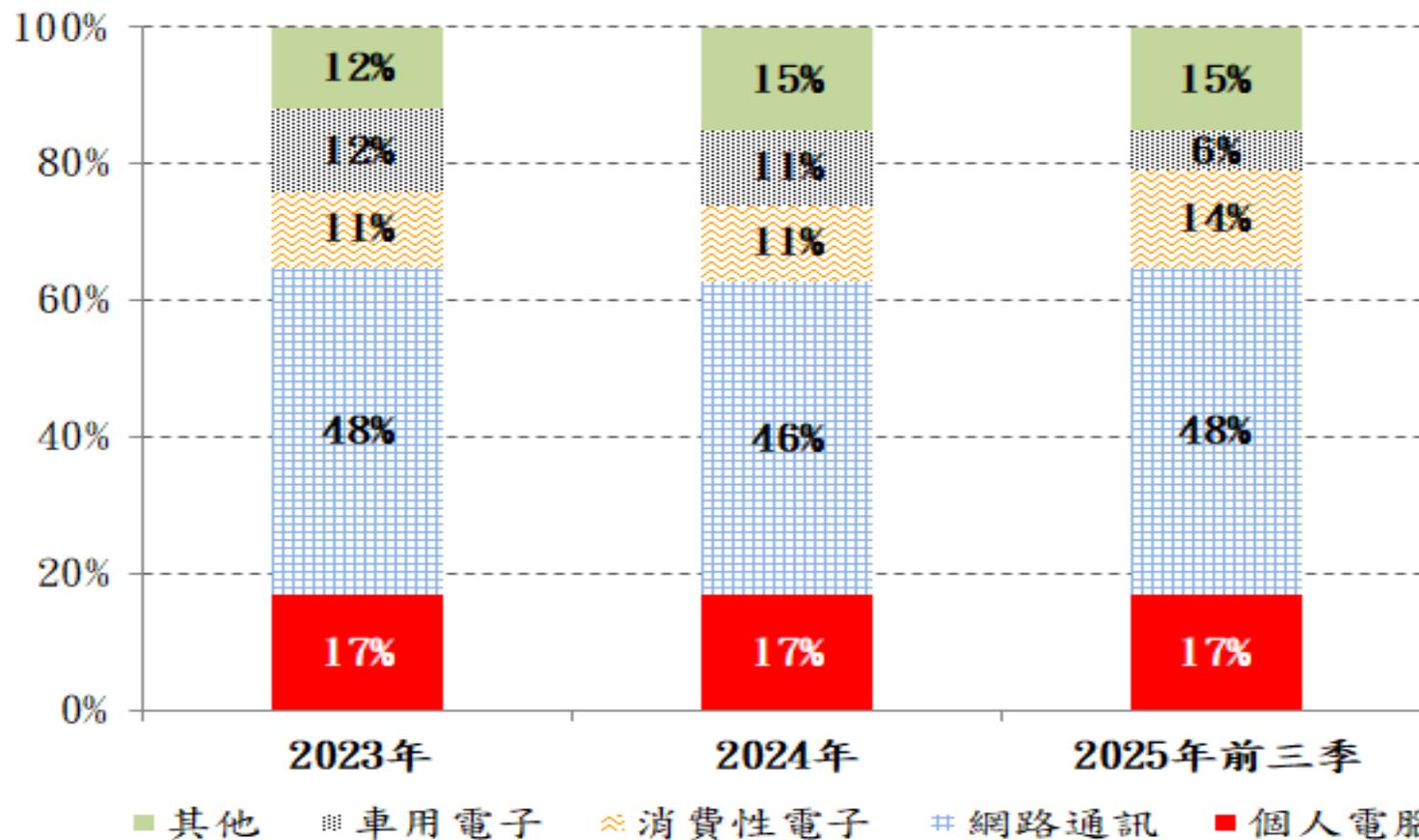


- 個人電腦市場維持穩定，2025年前三季相關營收比重持平。
- 受益於資料中心升級網通設備，高階交換器需求提升，帶動2025年前三季網通營收比重提升。



財務狀況

營業收入結構(應用別)



- 消費性電子客戶提前備貨，降低關稅提高風險，致2025年前三季相關營收提高。
- 汽車價格競爭嚴重，供應鏈亦受影響，致2025年前三季營收比重降低。
- 人工智慧與高效運算產品需求相對穩健，2025年前三季營收比重持平。



產品未來發展方向

持續拓展高值化產品

■ ABF載板

將與客戶共同開發更多AI雲端運算，如：伺服器處理器與客製化晶片(ASIC)等高算力產品，並因應大量資料的高速傳輸需求，開發垂直擴展(Scale-up)、水平擴展(Scale-out)及跨區域擴展(Scale-across)交換器應用載板，強化產品組合。

■ BT載板

本公司除開發新世代行動裝置的5G天線模組、電源管理晶片及智慧眼鏡應用載板外，亦將爭取光通訊市場的龐大商機，將量產光收發模組應用產品；此外，針對車用電子需求成長，將開發車用處理器及網路晶片載板，提升獲利。

■ 一般電路板

資料中心伺服器帶動HDI與多層板需求，本公司將開發並量產AI伺服器顯示卡、新世代伺服器網通卡；此外也針對各類邊緣AI產品商機，將量產高階PC與LED燈珠電路板，以及行動裝置中介板，使產品更加多元化。



2026年營運策略

公司持續執行四大轉型以提升競爭力

- 產品轉型：提升高值化、差異化產品比重，拓展新應用及市場。
- 事業轉型：開發新材料、新技術及新產品，深化公司產業佈局。
- 數位轉型：應用數位科技，精進AI及數位轉型，實現智能化營運。
- 低碳轉型：擴大綠電使用，致力節能減碳，落實循環經濟推動。



感謝您的聆聽

